KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/172

av den 16 november 2018

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ([1]), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller vissa farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Det kravet ska inte tillämpas på de användningar som förtecknas i bilaga III till direktiv 2011/65/EU.

(2) De olika kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU (kategorierna 1 till 11) är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3) Bly är ett ämne som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU. Användningen av bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar var däremot undantagen från begränsningen och förtecknas för närvarande i post 15 i bilaga III till det direktivet. Giltighetstiden för detta undantag, för kategorierna 1–7 och 10, var den 21 juli 2016.

(4) Kommissionen mottog en ansökan om förlängning av detta undantag före den 21 januari 2015, i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU. Undantaget fortsätter att gälla till dess att ett beslut om ansökan har fattats.

(5) Bly i lödpunkter används i flip-chip-anslutningar som lödpärlor för att fästa brickan vid chiphållaren. Lödpunkterna måste vara motståndskraftiga mot missanpassning vid den extremt höga strömtäthet som krävs och kunna skapa en lödningshierarki som möjliggör en stegvis montering och ombearbetning av komponenter i tillverkningsprocessen. De ska också ha en hög duktilitet för att minska termomekaniska påfrestningar i under-bump-metallizationstrukturer (UBM), i synnerhet i större kretsar.

(6) För vissa användningar som omfattas av det nuvarande undantaget är substitution eller eliminering av bly fortfarande inte vetenskapligt eller tekniskt genomförbart på grund av bristen på tillförlitliga substitut. Undantaget försämrar inte det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 ([2]). Det bör därför förlängas för dessa särskilda användningar.

(7) För alla andra användningar som för närvarande omfattas av undantag är villkoren för förlängning inte uppfyllda. Undantaget för dessa användningar bör fortsätta att tillämpas under 12 månader efter ikraftträdandet av denna delegerade förordning i enlighet med artikel 5.6 i direktiv 2011/65/EU.

(8) Eftersom det för de användningar som berörs av den förlängningen ännu inte finns några tillförlitliga alternativ på marknaden bör undantaget för dessa användningar förlängas för kategorierna 1–7 och 10 för den maximala giltighetstiden på fem år till den 21 juli 2021. Med tanke på resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitutioner har övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

([1]) EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.
([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9) För andra kategorier än kategorierna 1–7 och 10 fortsätter det befintliga undantaget att gälla enligt de giltighetstider som anges i artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU. Av tydlighetsskäl bör de sista giltighetsdagarna läggas till i bilaga III till det direktivet.

(10) Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna ska senast den 29 februari 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 mars 2020.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

I bilaga III ska punkt 15 ersättas med följande:

”15	Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar	Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut — den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument, — den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8, — den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.
15 a	Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar, där minst ett av följande kriterier är uppfyllt: — En halvledartekniknod på minst 90 nm. — En enda skiva på minst 300 mm² någon av halvledartekniknoderna. — Staplade skivpaket (stacked die packages) på minst 300 mm², eller kiselmellanlägg på minst 300 mm².	Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.”